

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年3月4日(04.03.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/039380 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/14 (2006.01) *C08K 3/08* (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/030596

(22) 国際出願日: 2020年8月11日(11.08.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-152675 2019年8月23日(23.08.2019) JP

(71) 出願人: 株式会社 A D E K A (**ADEKA CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1168554 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 縫田 祐介 (**NUIDA Yusuke**); 〒1168554 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 株式会社 A D E K A 内 Tokyo (JP). 細川 仁 (**HOSOKAWA Hitoshi**); 〒1168554 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 株式会社 A D E K A 内 Tokyo (JP). 森田 博 (**MORITA Hiroshi**); 〒1168554 東京都荒川区東尾久7丁目2番35号 株式会社 A D E K A 内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 近藤 利英子, 外 (**KONDO Rieko et al.**); 〒1010024 東京都千代田区神田和泉町1-13-1 水戸部ビル5階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** RESIN COMPOSITION, METHOD FOR FORMING CURED PRODUCT, AND CURED PRODUCT

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、硬化物の形成方法、及び硬化物

(57) **Abstract:** Provided are: a resin composition that contains copper particles and a specific resin, and is capable of producing a cured product having a low volume resistance value; and a cured product obtained by curing the resin composition. Said resin composition contains: (A) copper particles having an average particle size of 0.1-20 μm ; (B) a phosphoric acid-modified epoxy resin obtained by reacting a phosphoric acid (b1) with an epoxy compound (b2); and (C) a hardener, wherein the content of the component (B) is 0.1-30 parts by mass and the content of the component (C) is 0.1-5 parts by mass, with respect to 100 parts by mass of the total amount of the components (A) to (C). Furthermore, said cured product is obtained by curing the resin composition.

(57) 要約: 銅粒子と特定の樹脂を含有する、体積抵抗値の低い硬化物を製造することが可能な樹脂組成物、及びそれを硬化させた硬化物を提供する。(A) 平均粒径が0.1~20 μm である銅粒子、(B) リン酸類 (b1) とエポキシ化合物 (b2) とを反応させて得られるリン酸変性エポキシ樹脂、及び (C) 硬化剤を含有し、(A) ~ (C) 成分の総量100質量部に対する、(B) 成分の含有量が0.1~30質量部であり、(C) 成分の含有量が0.1~5質量部である樹脂組成物である。また、この樹脂組成物を硬化させた硬化物である。

WO 2021/039380 A1